



平成 27 年 5 月 11 日

各 位

上場会社名 T O W A 株式会社  
代 表 者 代表取締役社長 岡田 博和  
コード番号 6315  
問合せ先責任者 執行役員経営企画本部長  
蒲生 喜代重  
TEL (075) 692 - 0251

## リリース・フィルム販売開始に関するお知らせ

半導体パッケージなどの製造工程で離型材として用いられるリリース・フィルムについて T O W A ブランドでの販売を開始いたしましたのでお知らせいたします。

現在、スマートフォン、ウェアラブル端末などに採用されるハイエンドの半導体は、超微細化・積層化が日々進んでおります。このような難易度の高い製品に対して材料コストを抑えて安定的に生産できるモールド設備としてコンプレッション方式の PMC シリーズを市場に投入し客先のニーズに応じてまいりました。

当社では、このように製造装置を通してお客様の生産性向上に寄与する一方で、お客様の強い要望である、更なる製品単価引き下げに向けてお客様と問題解決に取り組んでまいりました。お客様からは、以前より消耗品であるリリース・フィルムのコスト高が指摘されており、社内で対応策を検討してまいりました。その結果、モールド工程に関わる各材料メーカーと協力して我々の装置に最適なリリース・フィルムを供給できる体制を整えることができたため、この度、T O W A ブランドでのリリース・フィルムの販売を開始いたしました。

両面梨地や片面梨地など 4 種類を取り揃え、当社のリリース・フィルムをお客様に対して、既に販売を開始しております。初年度売上目標を 1 億 5 千万円とし、徐々に売上を増やしていく予定です。

### 1. 商品名

「離型リリース・フィルム」

### 2. 商品規格

- ・厚み 53  $\mu$  m
- ・現在最大 700 mm 幅、将来最大 1,300 mm 幅
- ・長さ 260m 巻／本

以上